

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年5月19日(19.05.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/102780 A1

(51) 国際特許分類:
B32B 5/28 (2006.01) *C08L 53/02* (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01) *C08J 5/24* (2006.01)
C08F 290/12 (2006.01) *B32B 15/08* (2006.01)
C08L 39/04 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
C08L 51/04 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/041979

(22) 国際出願日: 2021年11月16日(16.11.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-190381 2020年11月16日(16.11.2020) JP

(71) 出願人: 昭和電工マテリアルズ株式会社 (SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 林千尋(HAYASHI, Chihiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 垣谷 稔(KAKITANI, Minoru); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 谷川 隆雄(TANIGAWA, Takao); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 明比 龍史(AKEBI,

Ryuji); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 佐藤 直義(SATO, Naoyoshi); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 堀江 晃(HORIE, Akira); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人大谷特許事務所 (OHTANI PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 虎ノ門ESビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: MALEIMIDE RESIN COMPOSITION, PREPREG, RESIN FILM, LAMINATED BOARD, PRINTED WIRING BOARD, AND SEMICONDUCTOR PACKAGE

(54) 発明の名称: マレイミド樹脂組成物、プリプレグ、樹脂フィルム、積層板、プリント配線板及び半導体パッケージ

(57) Abstract: Provided are a maleimide resin composition, a prepreg obtained using the maleimide resin composition, a resin film, a laminated board, a printed wiring board, and a semiconductor package, the maleimide resin composition containing (A) one or more selected from the group consisting of a maleimide compound having two or more N-substituted maleimide groups and a derivative thereof, (B) a modified conjugated diene polymer, and (C) a thermoplastic elastomer other than component (B), and component (B) being obtained by modifying a conjugated diene polymer (b1) having a vinyl group in a side chain thereof with a maleimide compound (b2) having two or more N-substituted maleimide groups.

(57) 要約: (A) N-置換マレイミド基を2個以上有するマレイミド化合物及びその誘導体からなる群から選択される1種以上と、(B) 変性共役ジエンポリマーと、(C) (B) 成分以外の熱可塑性エラストマーと、を含有し、前記(B)成分が、(b1) 側鎖にビニル基を有する共役ジエンポリマーを、(b2) N-置換マレイミド基を2個以上有するマレイミド化合物によって変性してなるものであるマレイミド樹脂組成物、該マレイミド樹脂組成物を用いたプリプレグ、樹脂フィルム、積層板、プリント配線板及び半導体パッケージを提供する。

[続葉有]

WO 2022/102780 A1

MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）